

2017 電路板學生優秀論文獎 興大榮獲三大獎

由台灣電路板協會舉辦的印刷電路板產業年度盛事「台灣電路板國際展覽會」，10月25日起一連三天在南港展覽館熱鬧登場。該協會同時於25日下午舉辦「2017電路板學生優秀論文獎」頒獎典禮，今年中興大學囊括三項大獎，包含金牌、銀牌與優勝，為此屆競賽的大贏家。

此次共頒發五個獎項，包括金獎、銀獎各一與三位優勝。金、銀獎皆由國立中興大學化學工程學系教授竇維平指導，金牌得主興大化工系碩士生張翊宣，主題為：Using Reduce Graphene Oxide (rGO) as a Conducting Layers for a PCB Metallization；銀獎得主為興大化工系碩士生陳柏廷，主題為：Copper Superfilling of Through Silicon Via and Through Glass Via Using Reduced Graphene Oxide Grafting Process。優勝得主則為興大材料科學與工程學系學生劉仁翔，由教授宋振銘指導，主題為：Development of CuAg Nanocomposites Pastes for Low-Temperature Low-Pressure Bong。

此競賽經過摘要、全文兩輪激烈評選，最後由五篇論文脫穎而出，獲得評審青睞。金獎、銀獎之學生除獲得十萬與八萬的高額獎金外，更可獲得海外參展全額補助，並於2018年前往華東電路板展進行得獎論文發表與展會參訪。得獎學生論文精彩內容，也於台灣電路板國際展覽會論文主題區內摘要呈現，並將於第12屆國際構裝暨電路板研討會中發表完整論文。

[感謝本校祕書室媒體公關組提供資料](#)